

●LGA-4B01 パッケージ許容損失

LGA-4B01 パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

1. 測定条件(参考データ)

測定条件：基板実装状態

雰囲気：自然対流

実装：Pb フリーはんだ

実装基板：基板 40mm×40mm (片面 1600mm²)

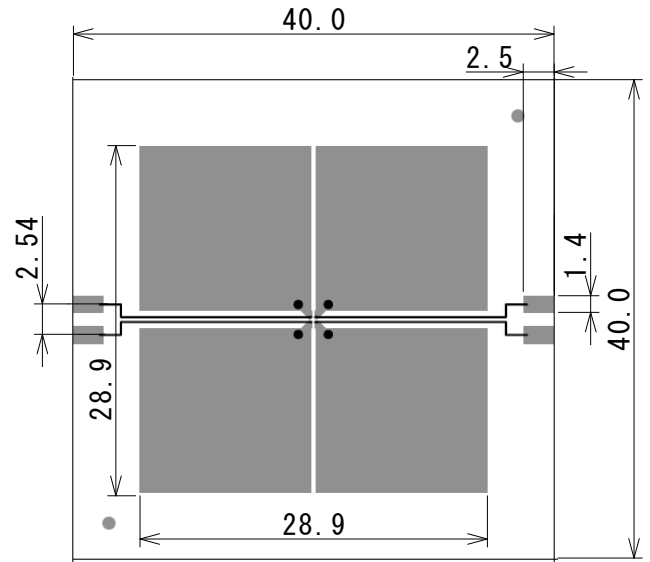
に対して銅箔面積

表面約 50%-裏面約 50%各リードと銅箔接続
(各リード表面約 12.5%-裏面約 12.5%の銅箔
と接続)

基板材質：ガラスエポキシ (FR-4)

板厚：1.6mm

スルーホール：ホール径 0.8mm 4個



評価基板レイアウト(単位:mm)

2. 許容損失-周囲温度特性

基板実装(T_{jmax}=125°C)

周囲温度(°C)	許容損失 Pd (mW)	熱抵抗(°C/W)
25	600	166.67
85	240	

